



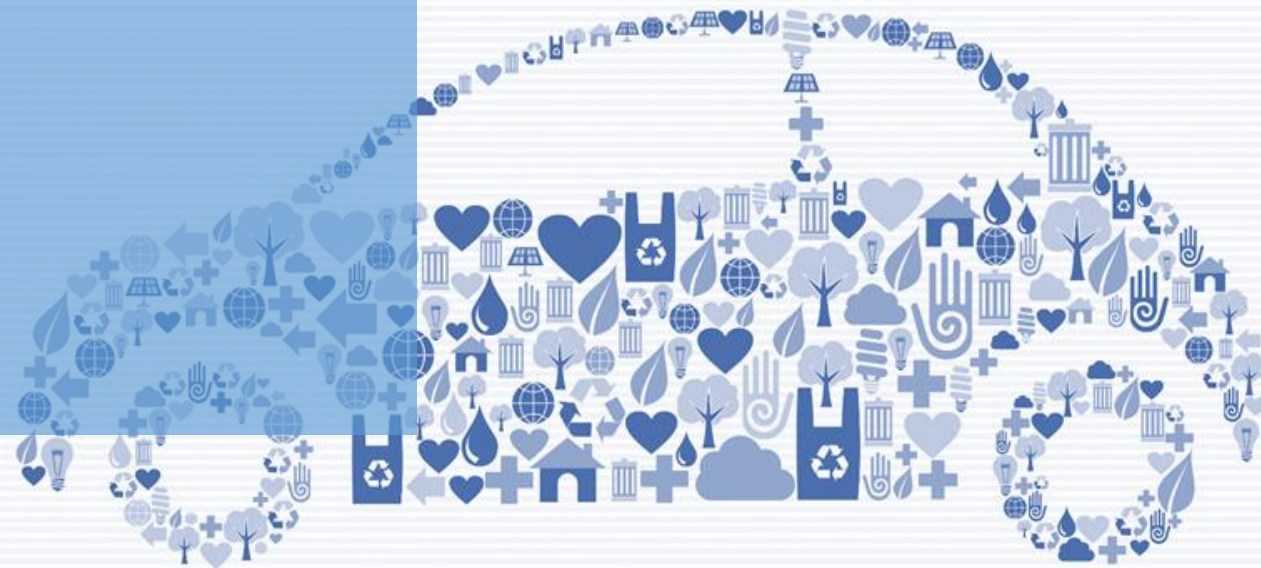
JCU CORPORATION

第63期・2023年3月期 決算説明資料

株式会社JCU

東証プライム 4975

2023年5月11日(木)



【累計会計期間】 JCU（単体）⇒ 2022.4～2023.3
海外子会社 ⇒ 2022.1～2022.12

薬品事業

分野向け 電子

- 中国は、個人消費の停滞および、巣ごもり需要の終焉に伴い、スマートフォンやパソコン、タブレットなどの高機能電子デバイス、サーバー向けプリント基板の需要が減少しましたが、当連結会計年度の薬品需要は横ばいに推移
- 台湾は、サーバー、高機能電子デバイス向け半導体パッケージ基板の需要が堅調に推移し、下期において、在庫調整局面となりましたが、当連結会計年度の薬品需要は増加
- 韓国は、半導体市場の需要が鈍化し、半導体パッケージ基板メーカーにおいて在庫調整の動きが継続し、当連結会計年度の薬品需要は減少

分野向け 自動車

- 国内は、半導体、部品不足が緩和されたことで自動車の生産台数は回復基調が見られ、当連結会計年度の薬品需要は増加
- 中国は、半導体不足、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自動車の生産台数は減少しましたが、当連結会計年度の薬品需要は横ばいに推移

装置事業

- 新型コロナウイルス感染症の影響による先送り案件の再開、及び電子分野めっき装置の新規投資需要の増加により、売上高、受注高、受注残高は大幅に増加

2023年3月期 連結実績



(単位：百万円)

決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期		
	実績	実績	予想	実績	対前期増減率
売上高	21,192	24,256	26,500	27,137	11.9%
営業利益	6,799	8,990	9,100	9,285	3.3%
経常利益	6,922	9,231	9,100	9,369	1.5%
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	4,708	6,370	6,300	6,013	△5.6%
1株当たり 四半期純利益	178円33銭	243円82銭	243円46銭	232円62銭	—

(注) 一部の在外連結子会社の留保利益に係る将来加算一時差異について繰延税金負債を計上したこと等により、法人税等調整額が大幅に増加したため、親会社株主に帰属する当期純利益が減少しました。

貸借対照表 要約



(百万円)	2022年3月期	2023年3月期
流動資産	32,507	36,646
現金及び預金	19,519	24,180
受取手形及び売掛金	8,501	8,526
たな卸資産	3,632	2,852
固定資産	8,385	8,255
有形固定資産	5,459	6,081
投資その他の資産	2,870	2,126
資産合計	40,892	44,901
流動負債	6,712	6,164
支払手形及び買掛金（電子記録債務含む）	2,736	2,397
短期借入金（一年内長期含む）	705	754
固定負債	1,013	875
長期借入金	540	288
負債合計	7,726	7,039
純資産合計	33,166	37,861
負債・純資産合計	40,892	44,901

※一部の勘定科目について省略しております。

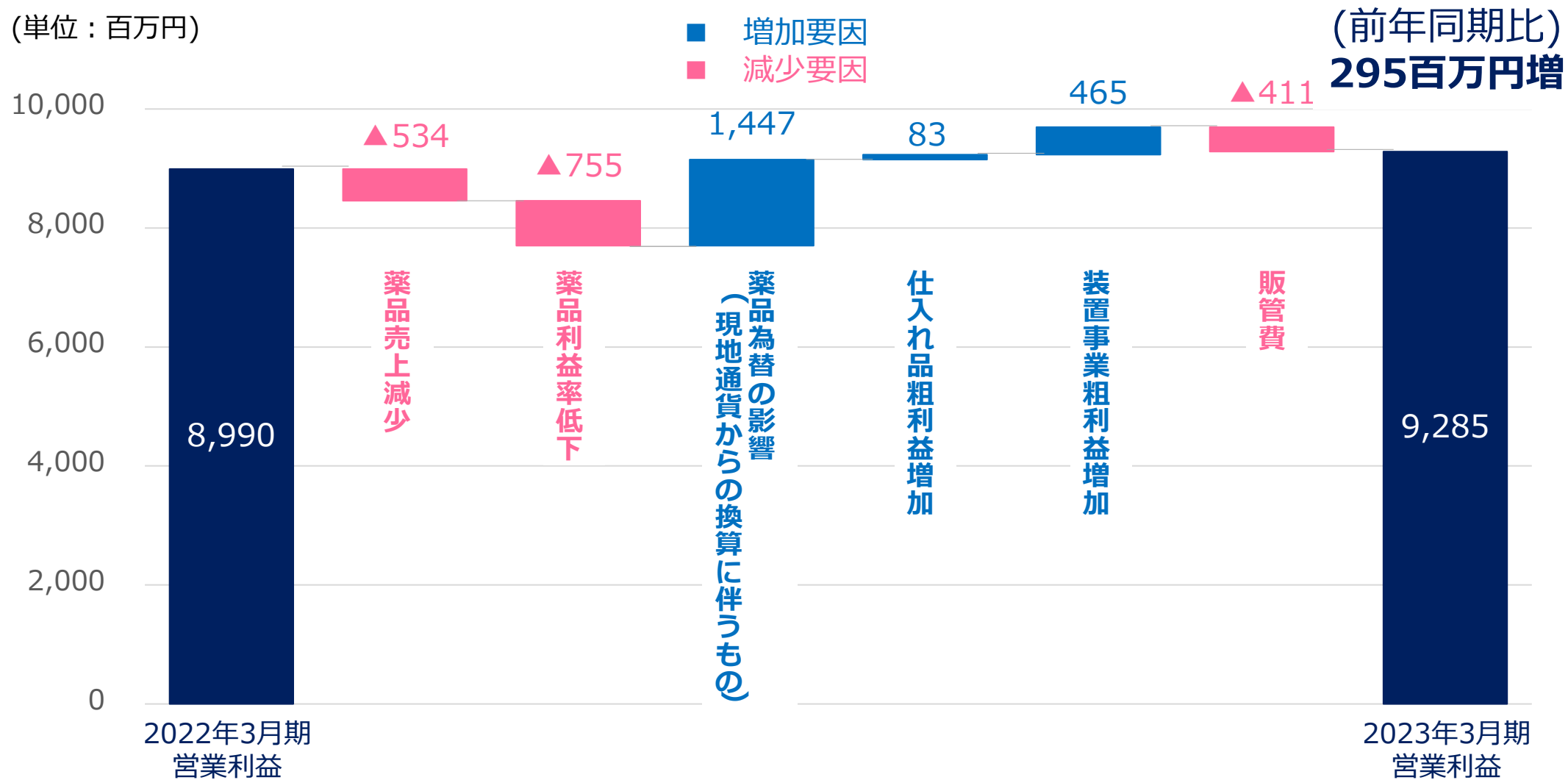
為替感応度（連結年換算）：上記主要通貨1%の変動で、連結営業利益0.9億円程度

(単位：円)

	2022年 3月期	2023年3月期					2024年 3月期 (予想)
		(期首予想)	1Q	2Q	3Q	4Q	
中国 人民元 (C N Y)	17.03	17.20	18.29	18.93	19.35	19.48	19.34
台 湾 ド ル (T W D)	3.93	4.00	4.15	4.28	4.37	4.41	4.36
韓 国 ウォ ン (K R W)	0.0960	0.0940	0.0964	0.0996	0.1008	0.1017	0.1039

(注) 当社の主要な外国通貨は、中国 人民元・台湾ドル・韓国ウォンであり、いずれも、期中平均レートを採用しております。

2023年3月期 連結営業利益 増減内容



2024年3月期 業績予想



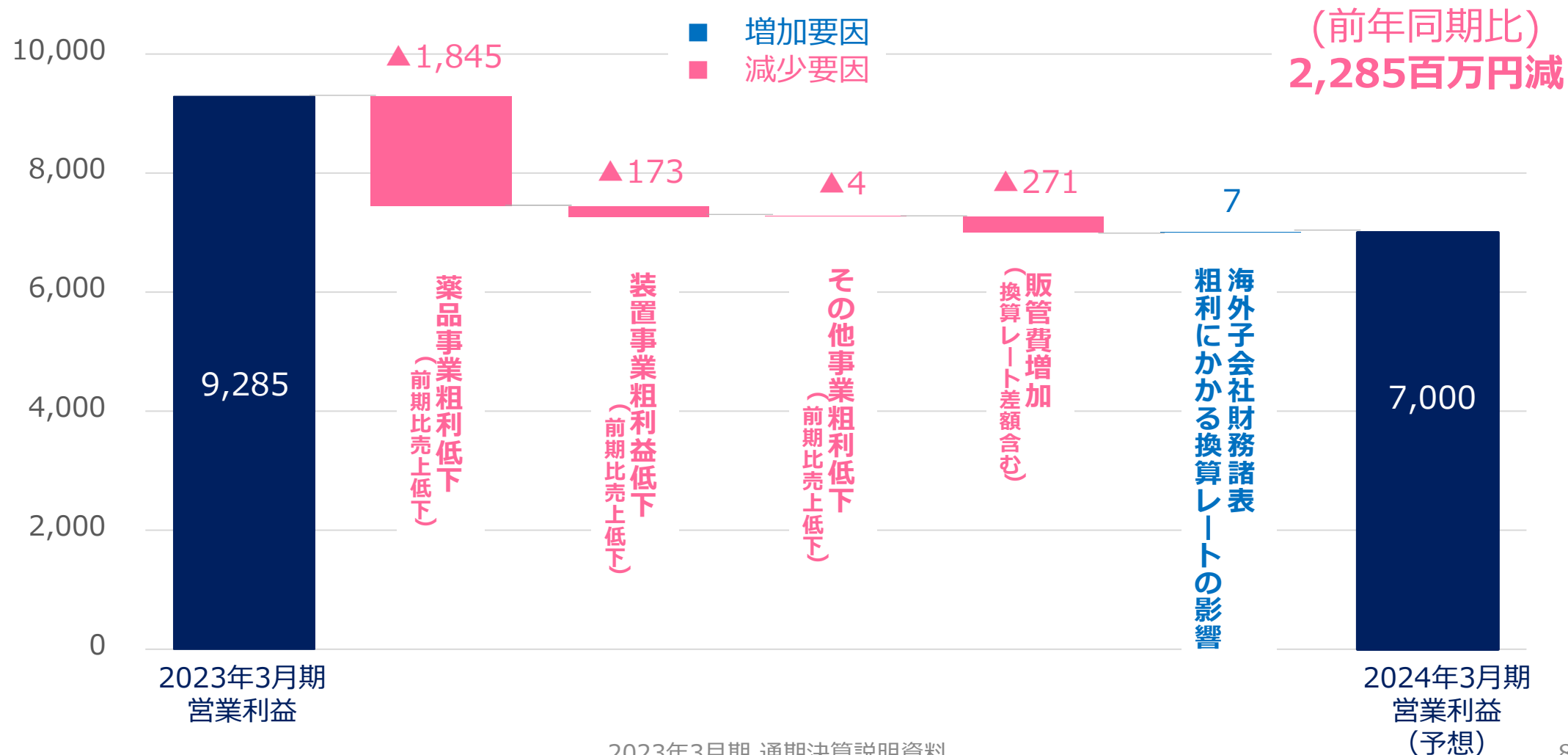
(単位：百万円)

決算期	2023年3月期 実績	2024年3月期 予想	前期に対する 増減率
売上高	27,137	25,000	△7.9%
営業利益	9,285	7,000	△24.6%
経常利益	9,369	7,000	△25.3%
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	6,013	4,800	△20.2%
1株当たり 四半期純利益	232円62銭	187円30銭	—

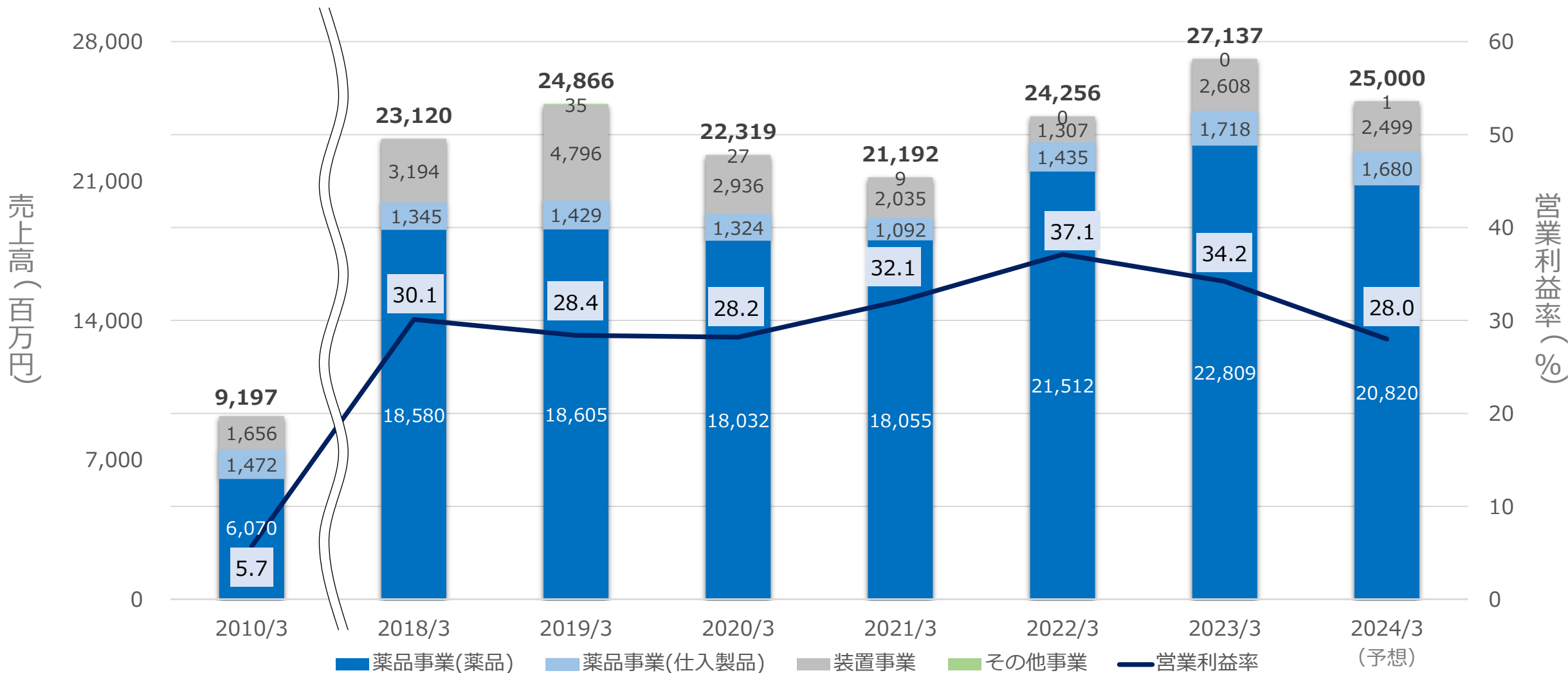
2024年3月期 連結営業利益 業績予想



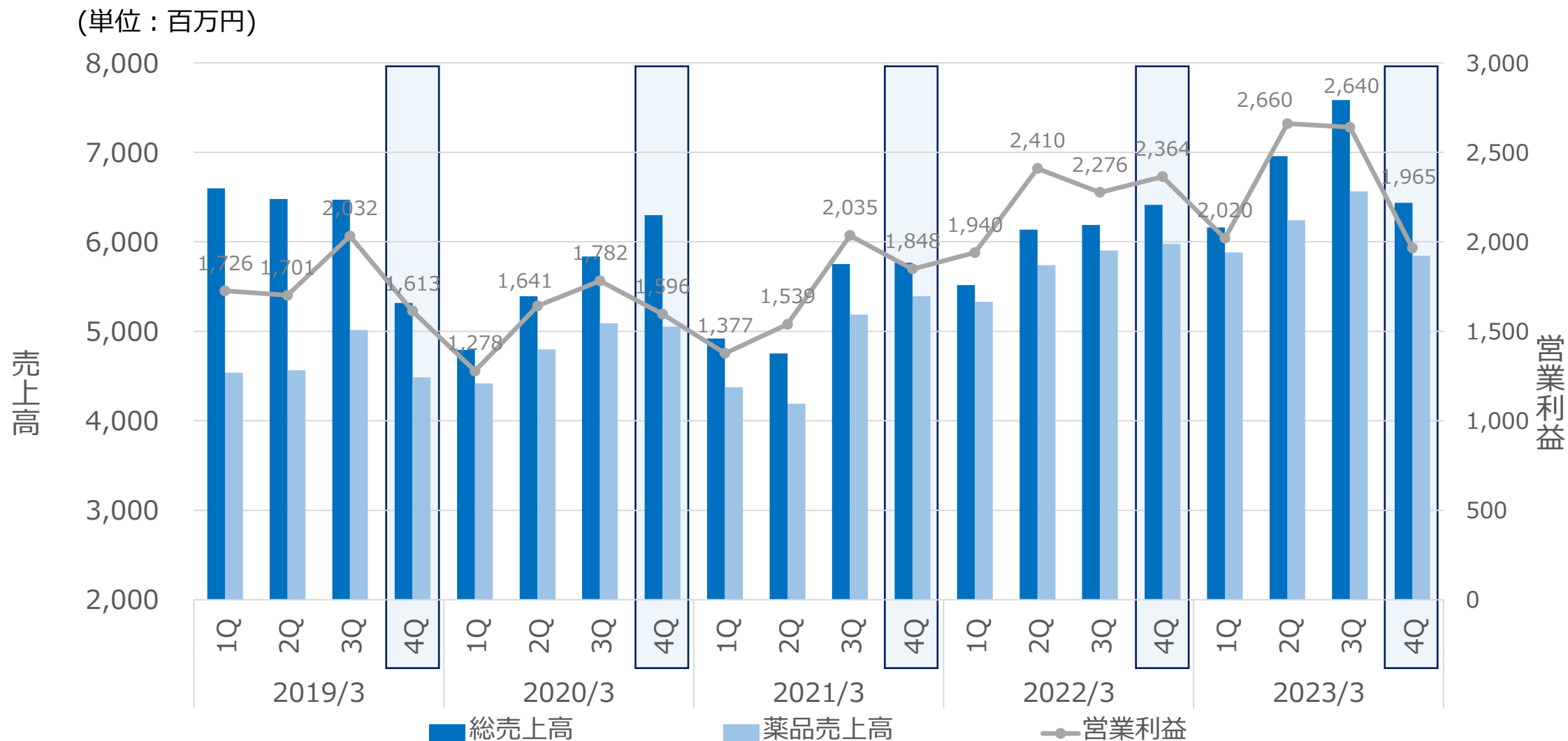
(単位：百万円)



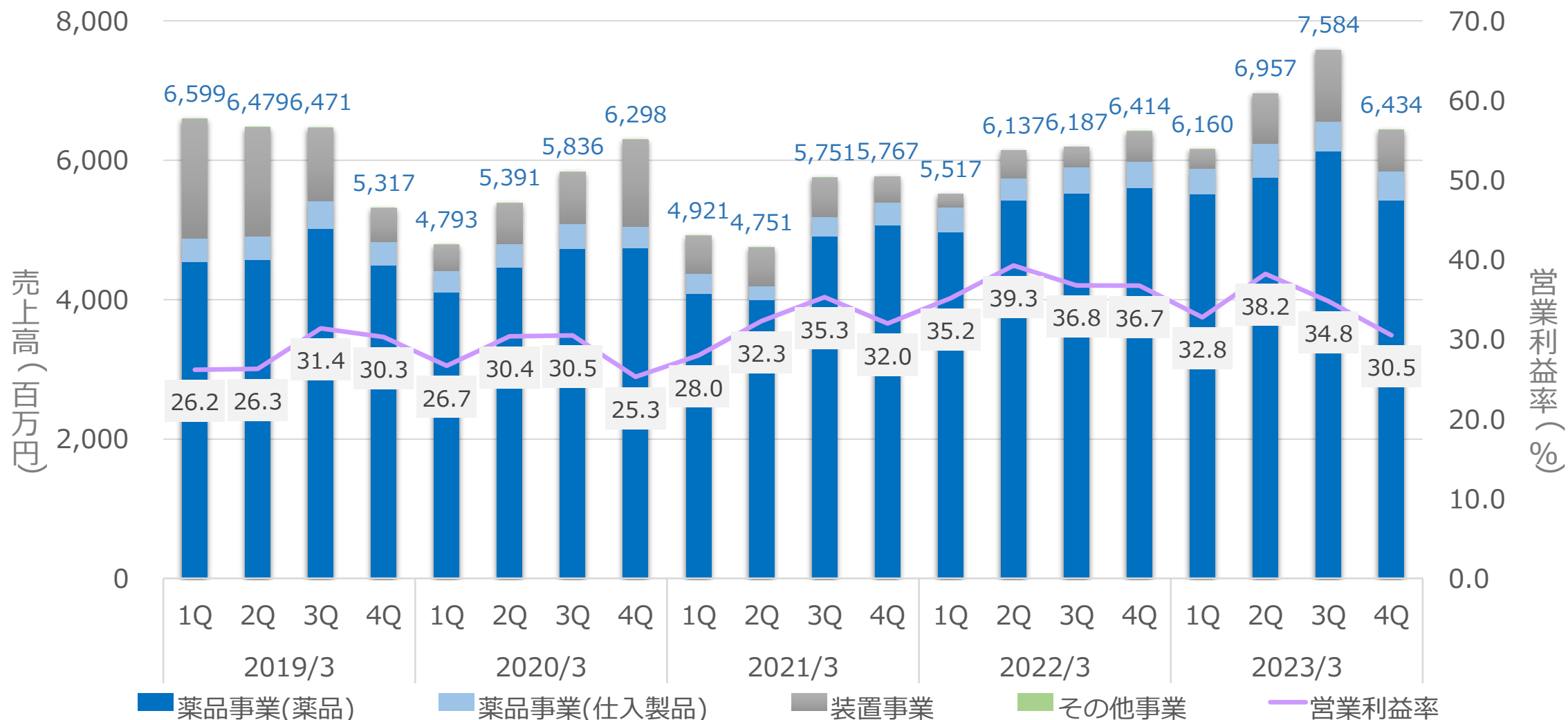
年度別 連結業績の推移（セグメント別）



四半期別 連結業績の推移



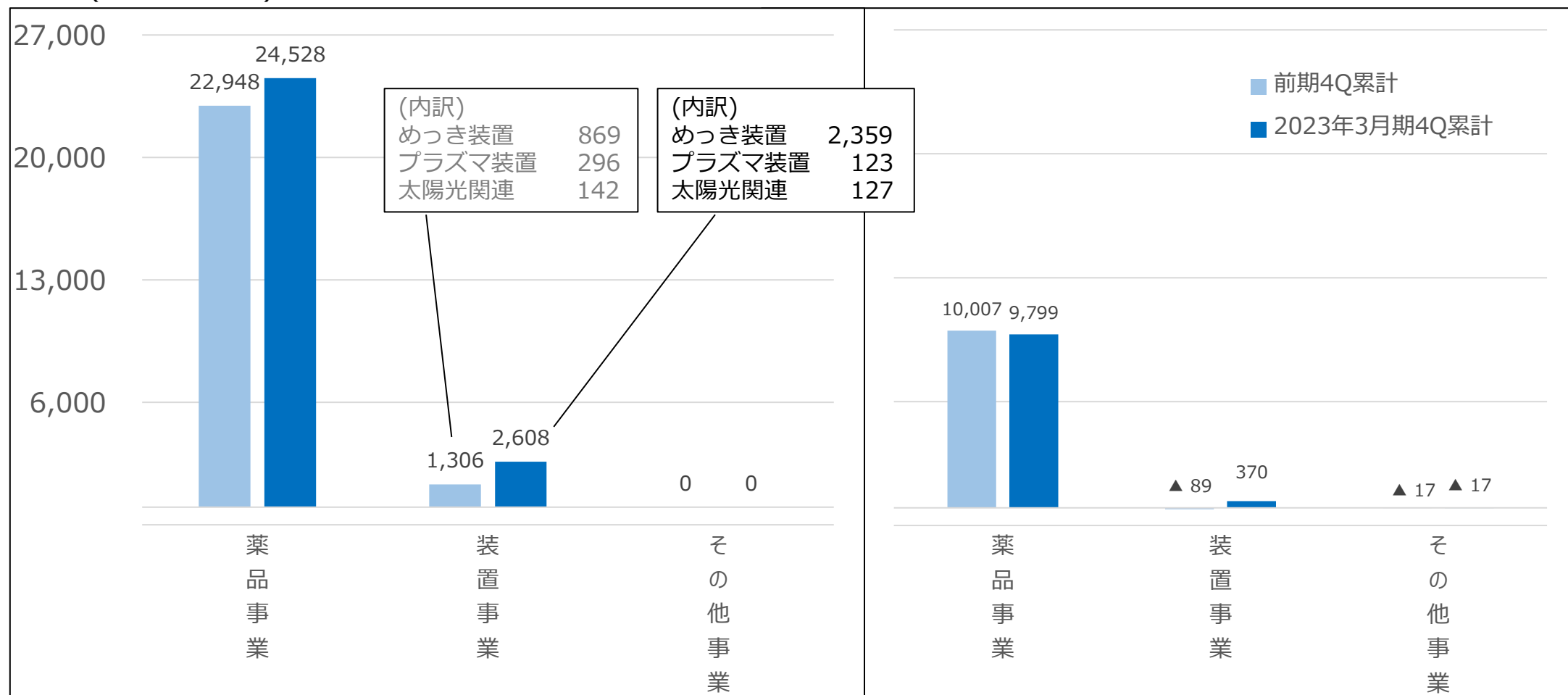
四半期別 連結業績の推移(セグメント別)



2023年3月期 連結セグメント業績



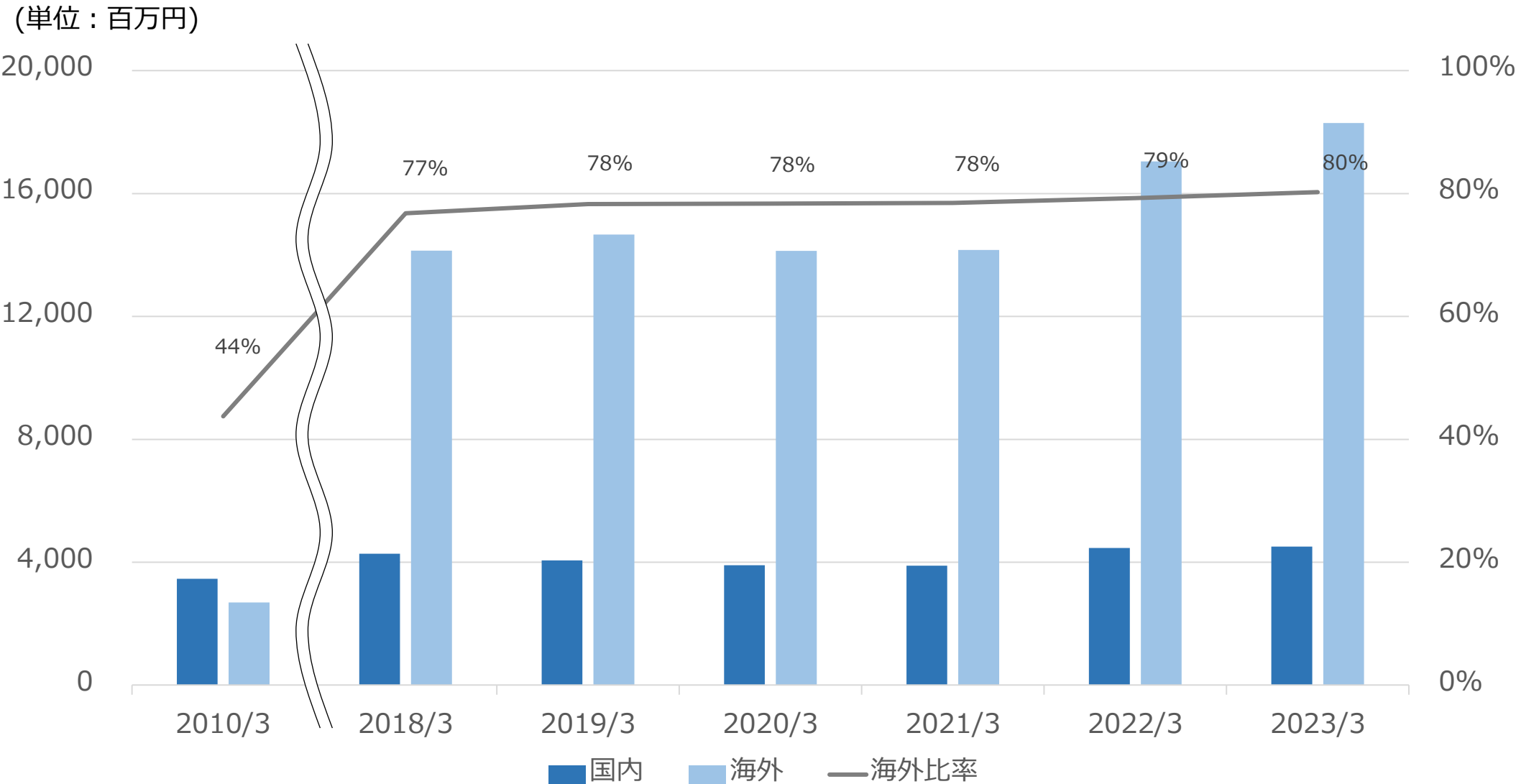
(単位：百万円)



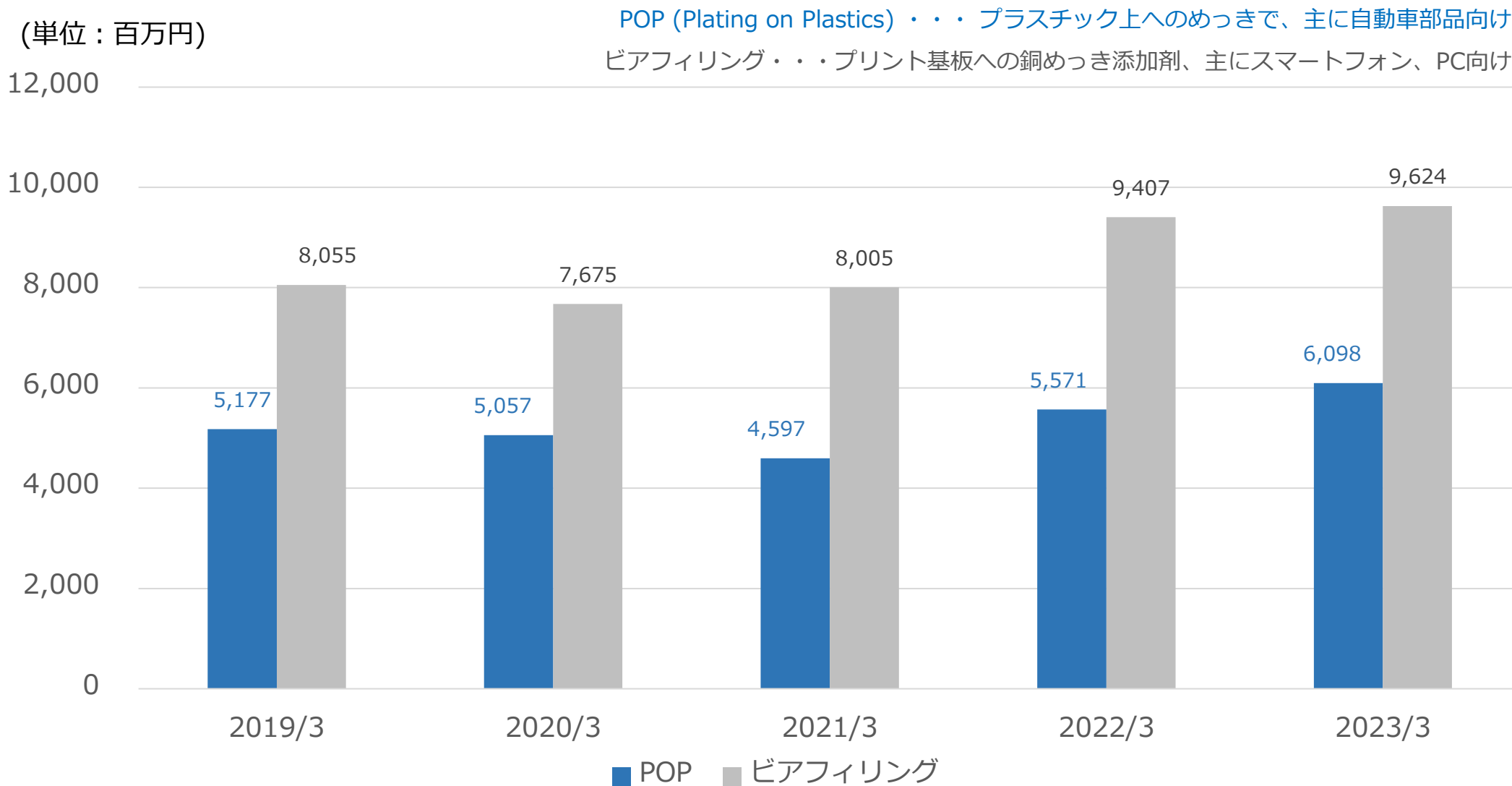
売上高

セグメント利益 (損失)

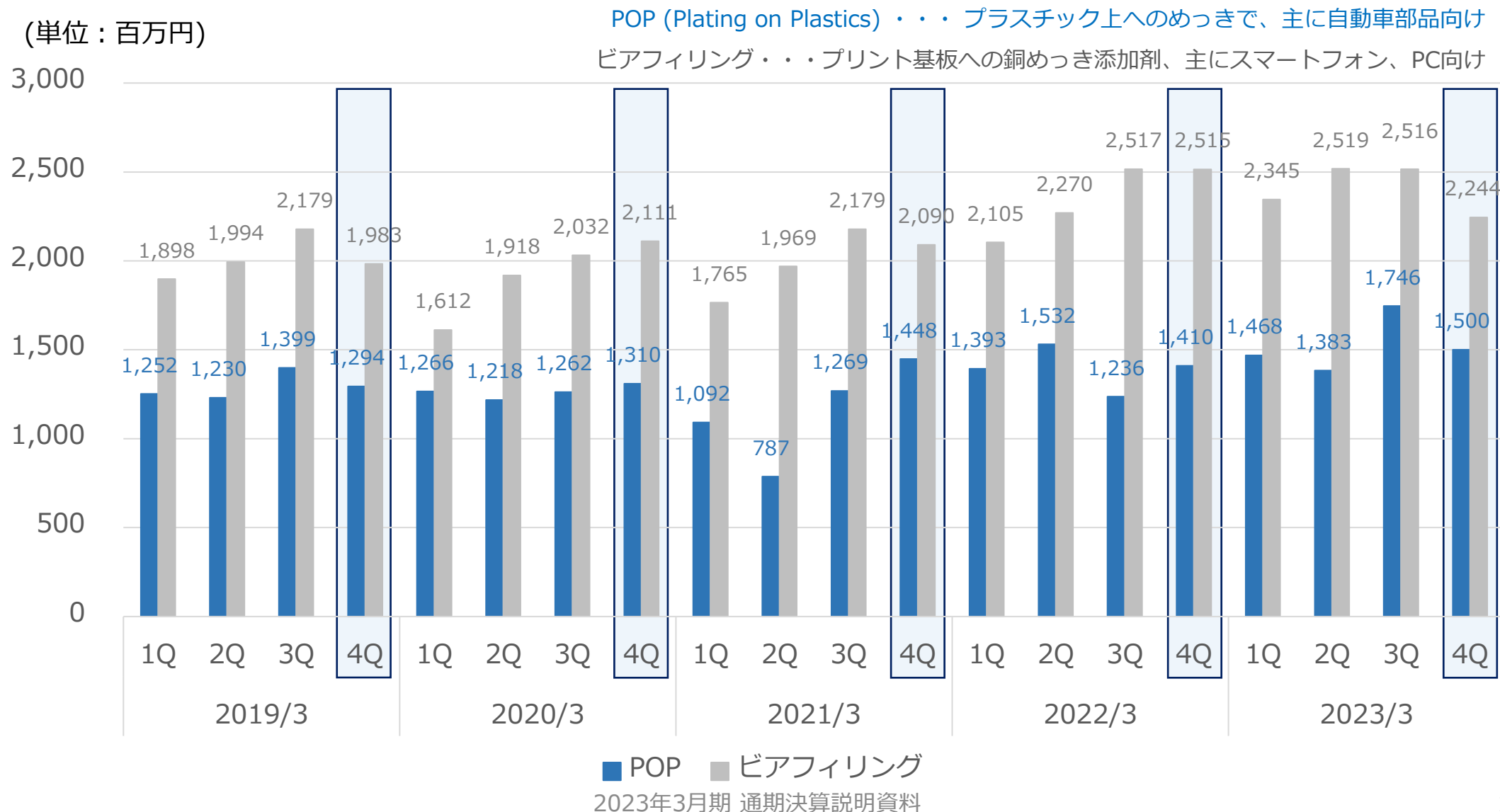
国内外薬品売上高推移



年度別 POP,ビアフィリング用薬品の売上高推移



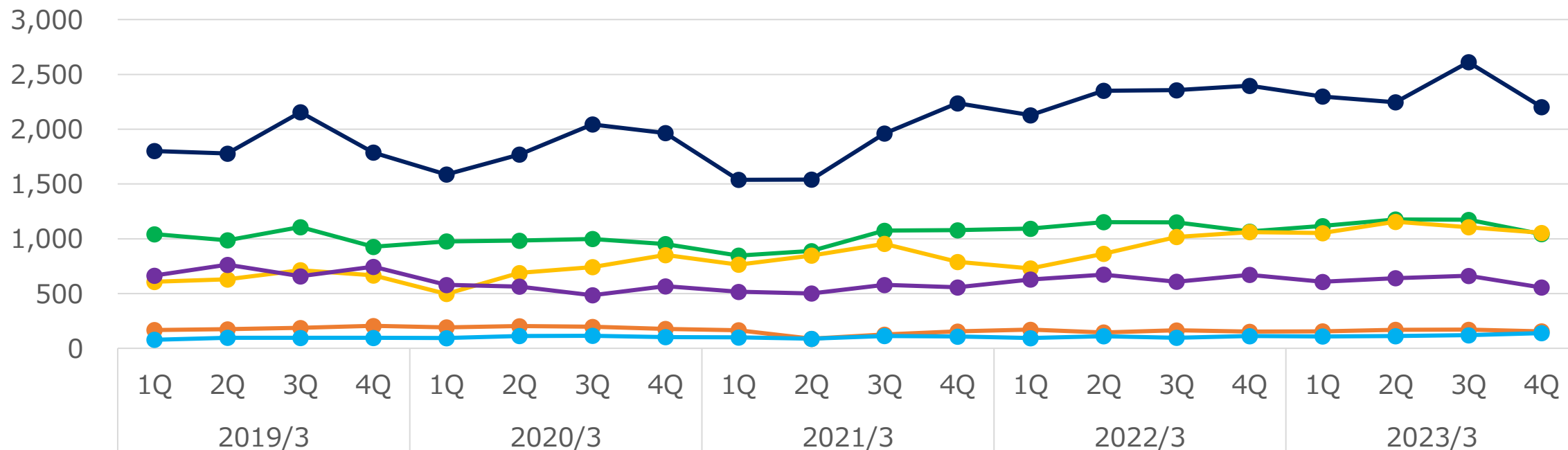
四半期別 POP,ビアフィリング用薬品の売上高推移



四半期別 地域別薬品売上高の推移



(単位：百万円)



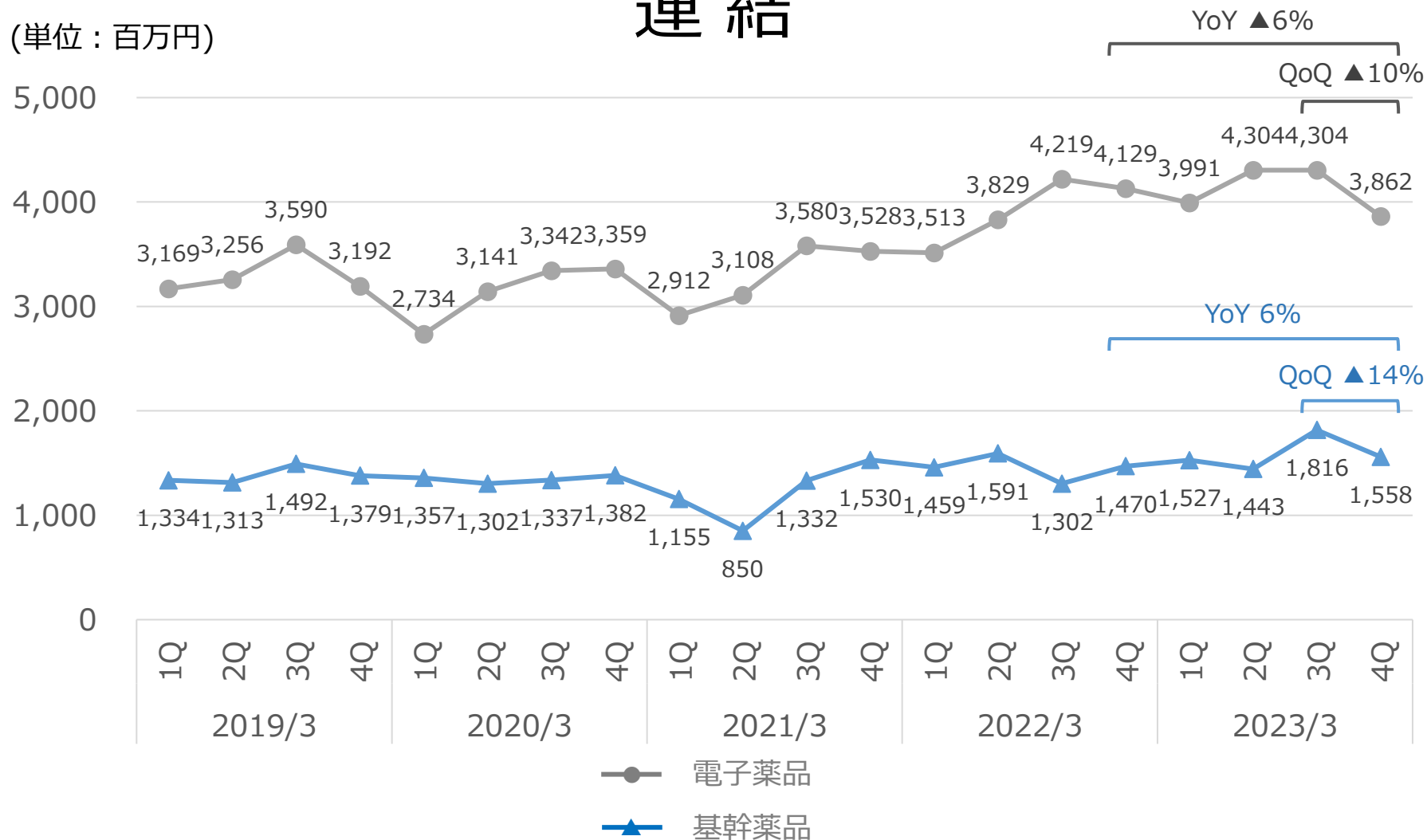
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
	2019/3				2020/3				2021/3				2022/3				2023/3			
● 日本	1,041	986	1,107	927	968	975	967	944	842	866	1,071	1,073	1,092	1,152	1,150	1,166	1,117	1,177	1,173	1,043
● 中国	1,800	1,778	2,155	1,786	1,580	1,766	2,038	1,969	1,535	1,540	1,961	2,237	2,133	2,353	2,359	2,391	2,307	2,247	2,612	2,203
● 台湾	606	629	712	666	497	682	739	850	756	833	953	790	732	864	1,018	1,060	1,052	1,155	1,106	1,054
● 韓国	664	762	657	744	579	559	485	567	516	500	579	557	629	673	608	672	607	641	662	556
● タイ	168	175	188	205	192	203	193	179	166	83	131	155	170	145	164	152	156	170	170	155
● ベトナム	80	98	95	97	95	113	115	101	100	89	114	107	94	111	97	112	109	112	120	139

四半期別 地域別薬品売上高の推移



連結

(単位：百万円)



(電子薬品) 主力製品：ビアフィリング
プリント基板、コネクタ、
半導体分野向けの表面処理(めっき)薬品

累計前期比：5%

(基幹薬品) 主力製品：POP
装飾、防錆分野向けの薬品
主に自動車部品、水栓金具等の
表面処理(めっき)薬品

累計前期比：9%

四半期別 地域別薬品売上高の推移



国内

(単位：百万円)

1,000

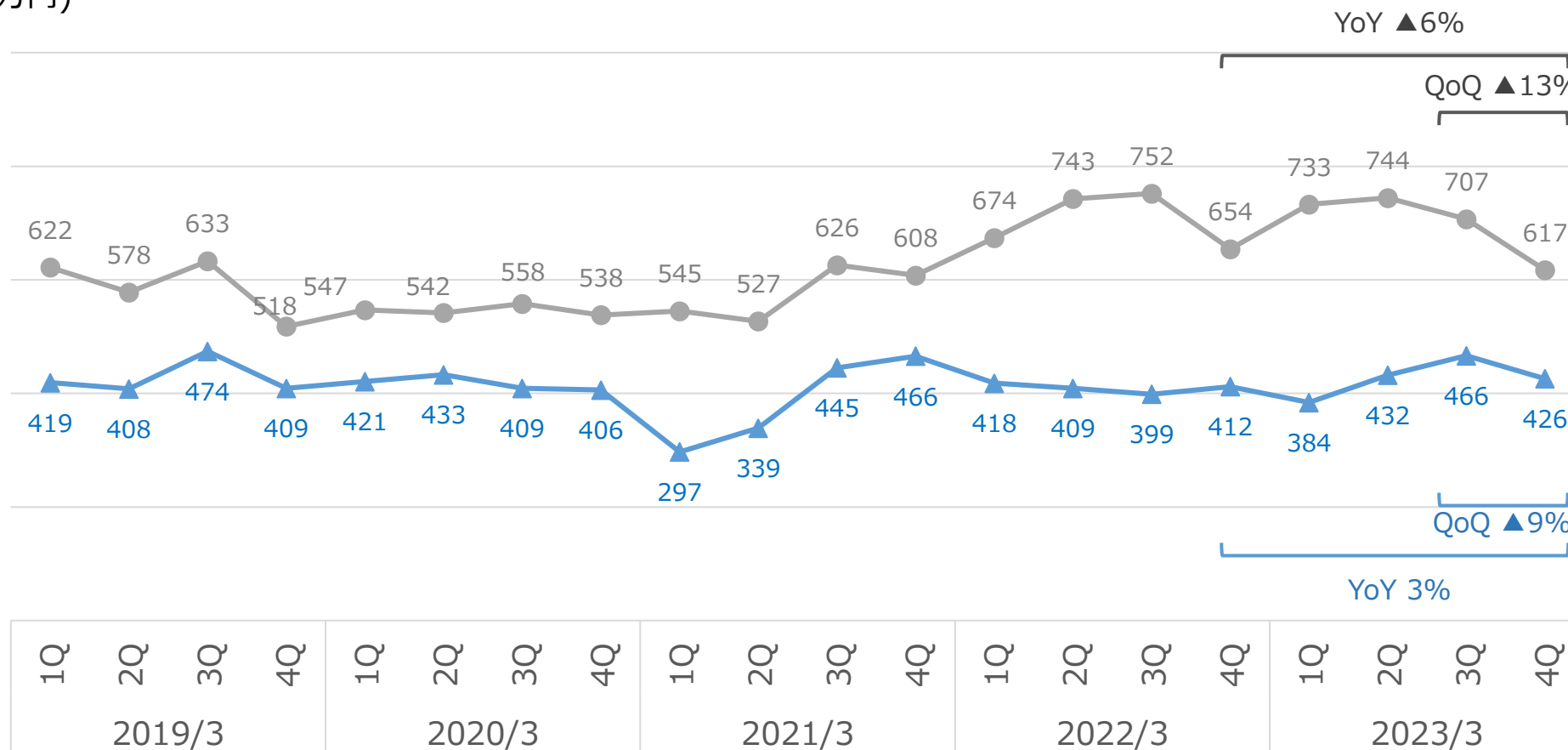
800

600

400

200

0



● 電子薬品

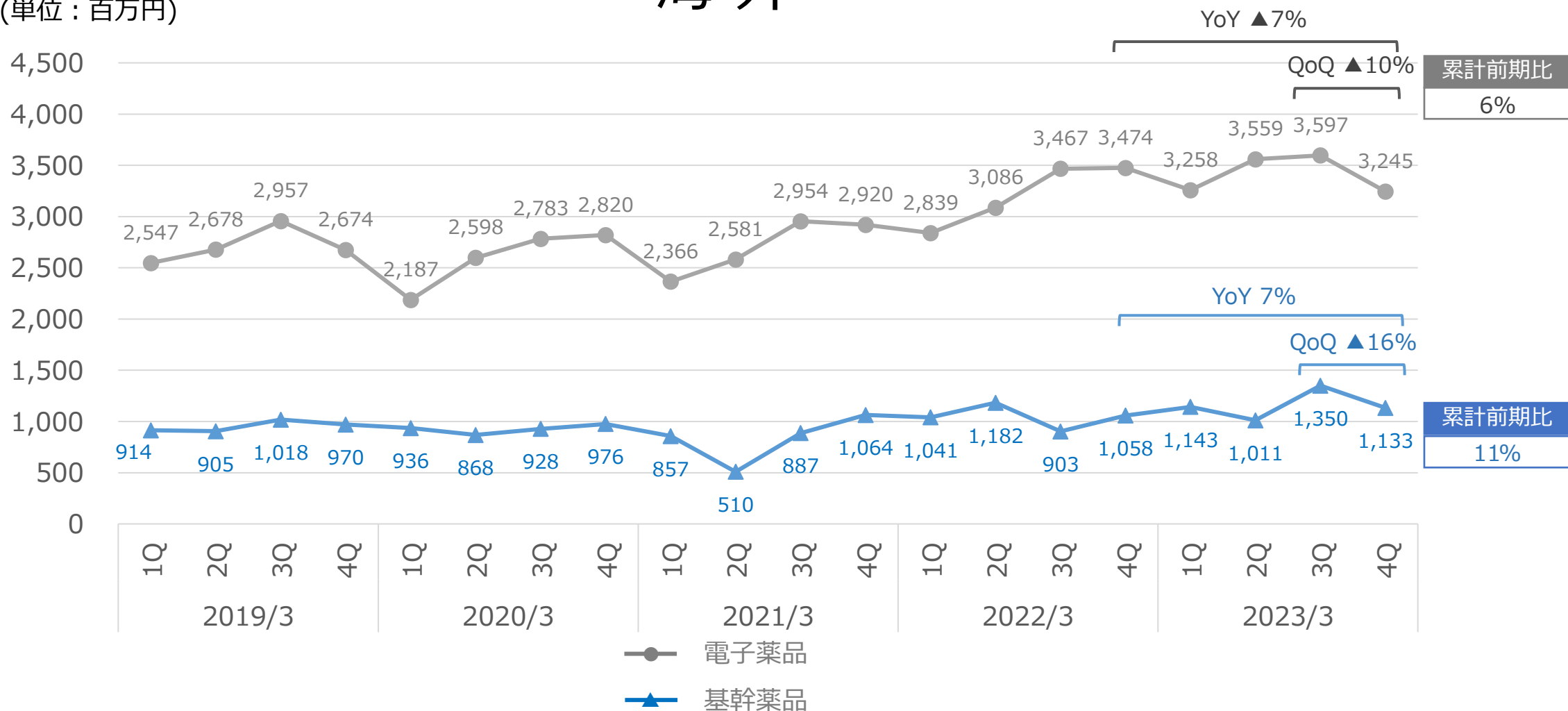
▲ 基幹薬品

四半期別 地域別薬品売上高の推移



海外

(単位：百万円)

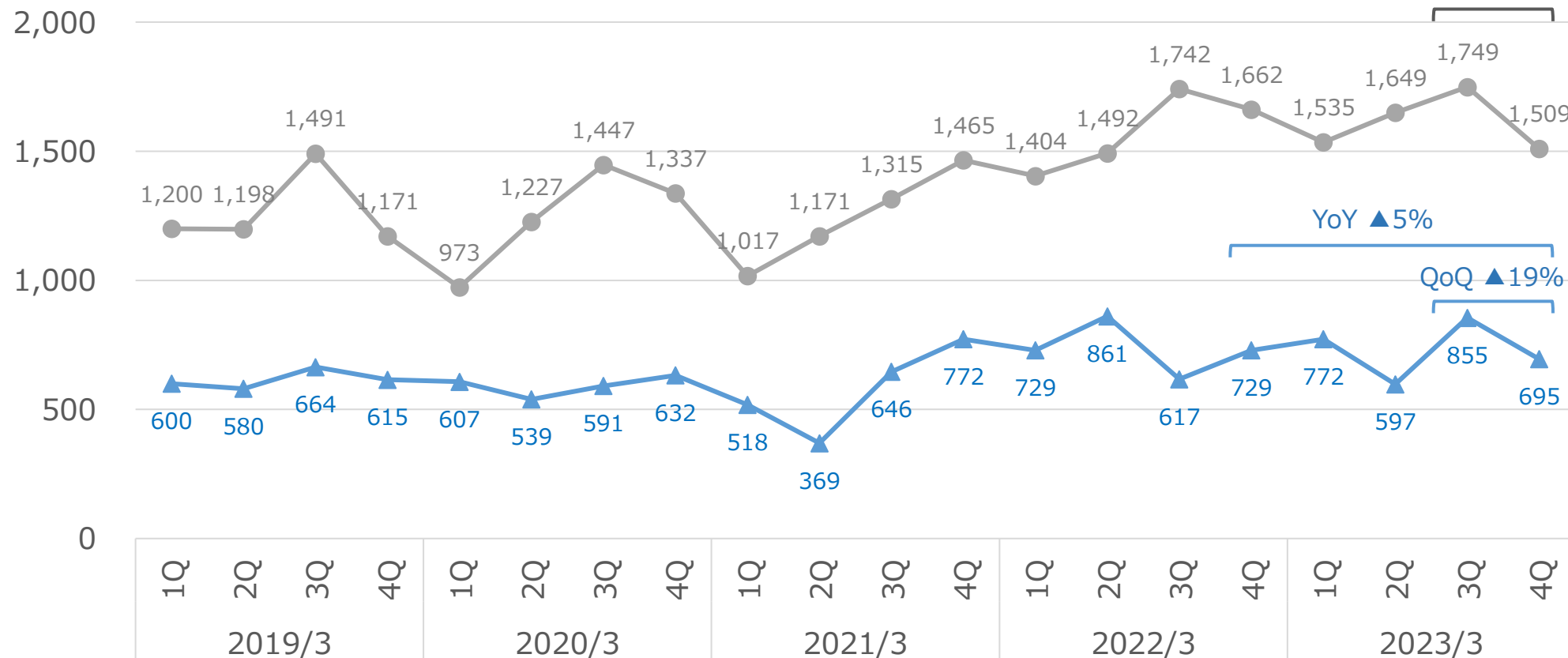


四半期別 地域別薬品売上高の推移



中国

(単位：百万円)



累計前期比
2%

累計前期比
▲1%

● 電子薬品

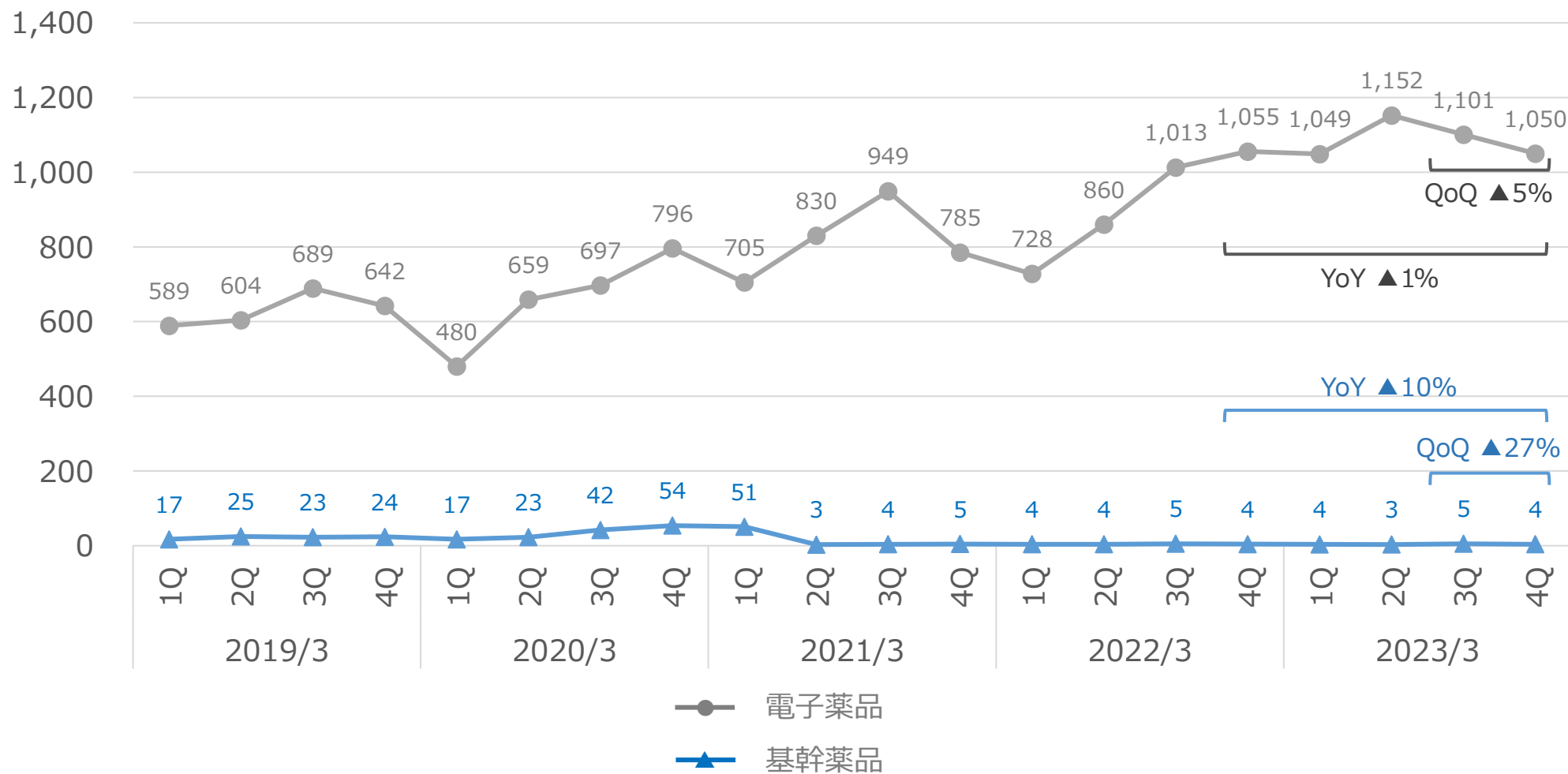
▲ 基幹薬品

四半期別 地域別薬品売上高の推移



台湾

(単位：百万円)

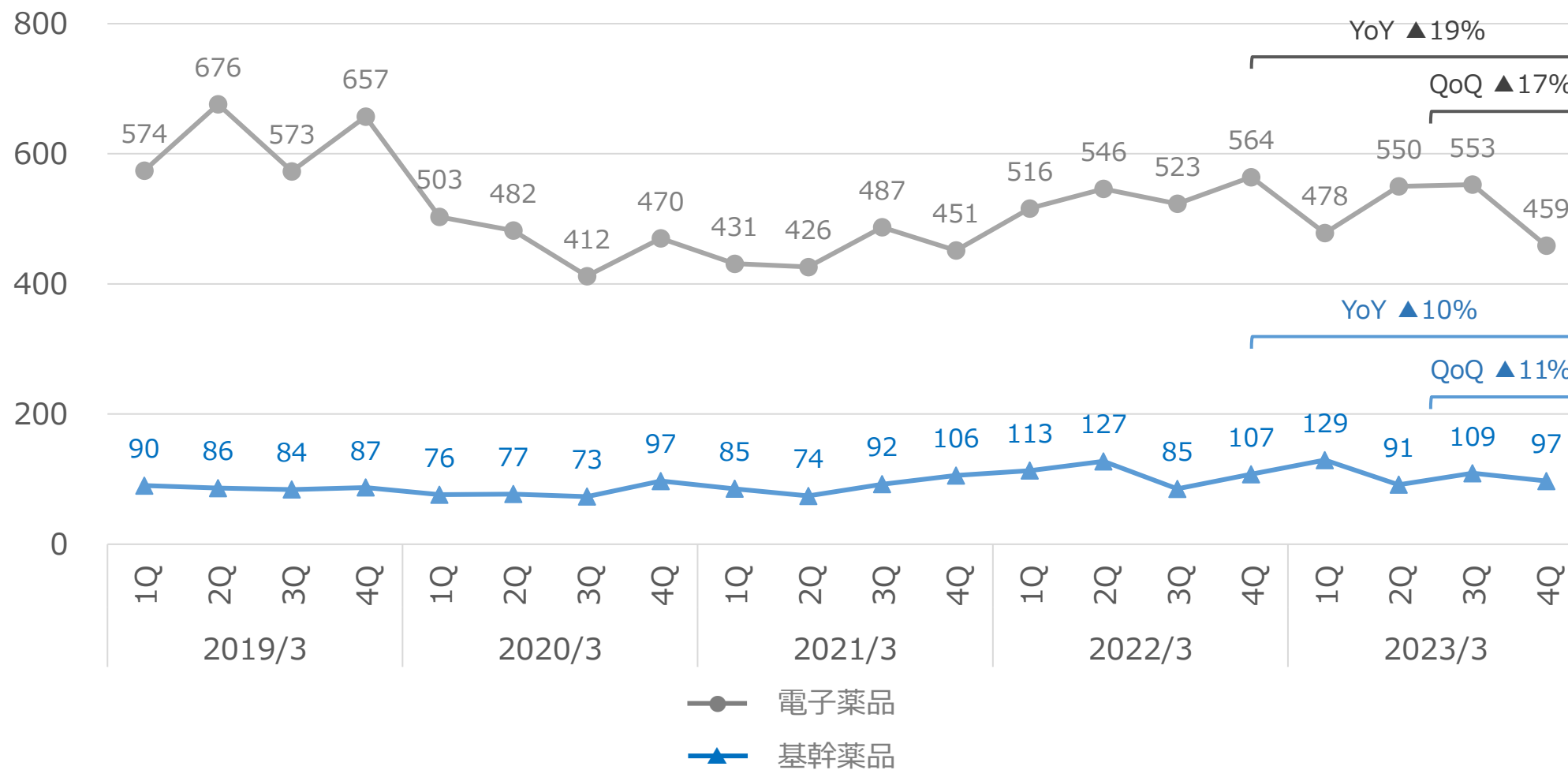


四半期別 地域別薬品売上高の推移

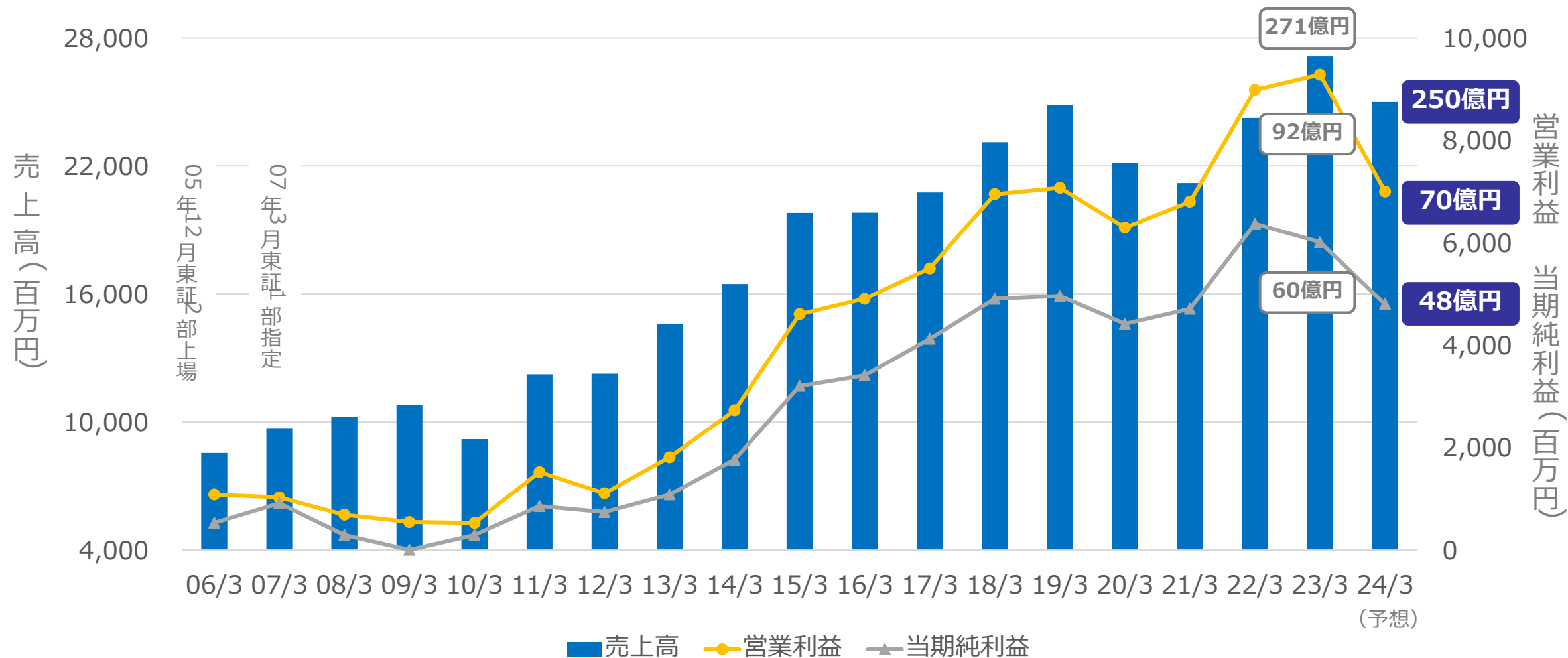


韓国

(単位：百万円)

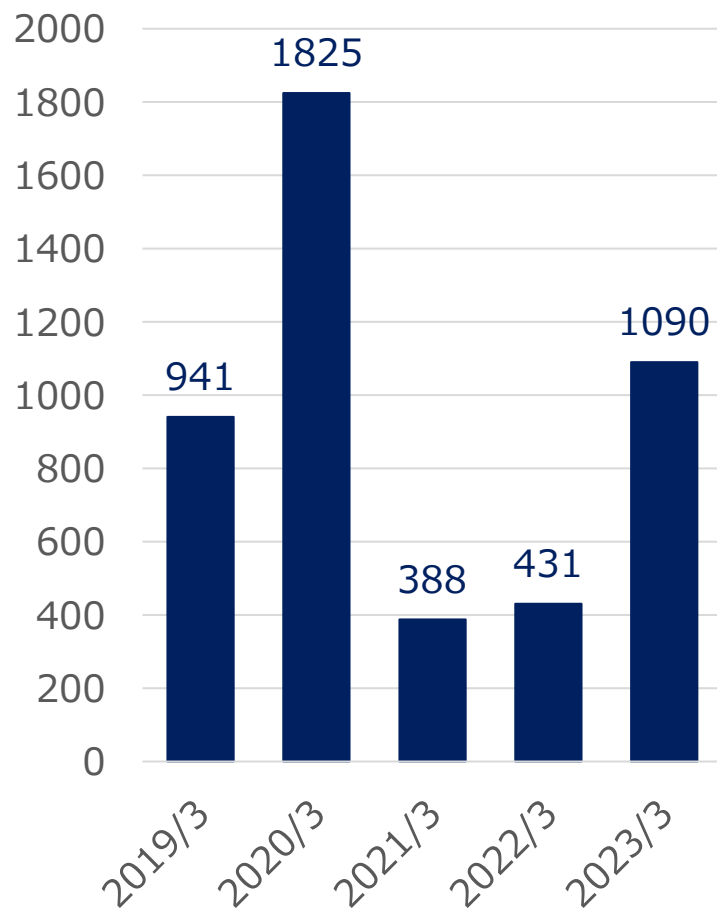


上場からの業績推移

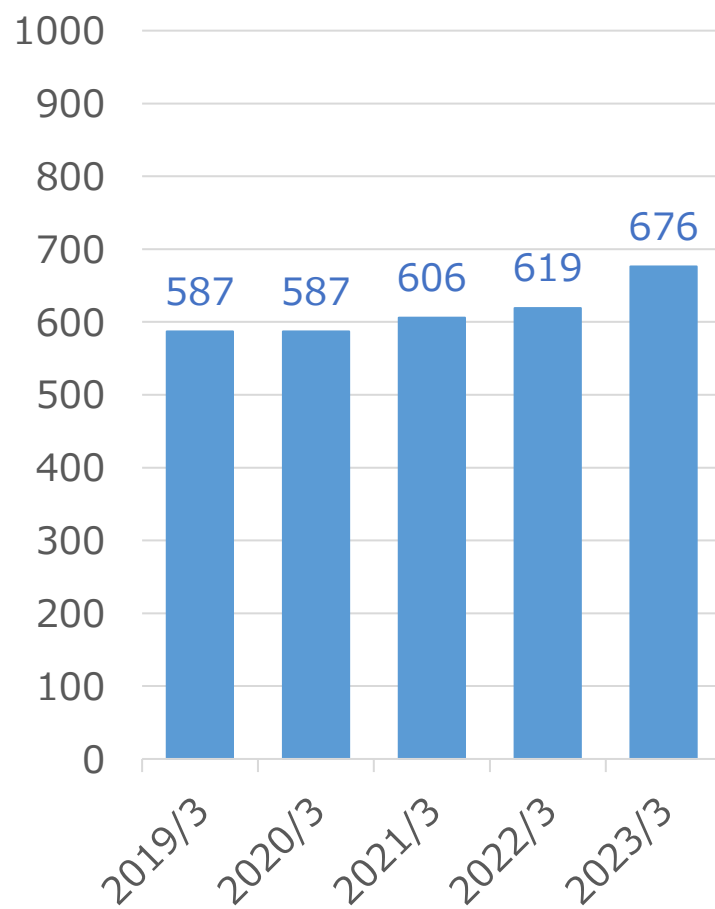


設備投資額、減価償却費および研究開発費

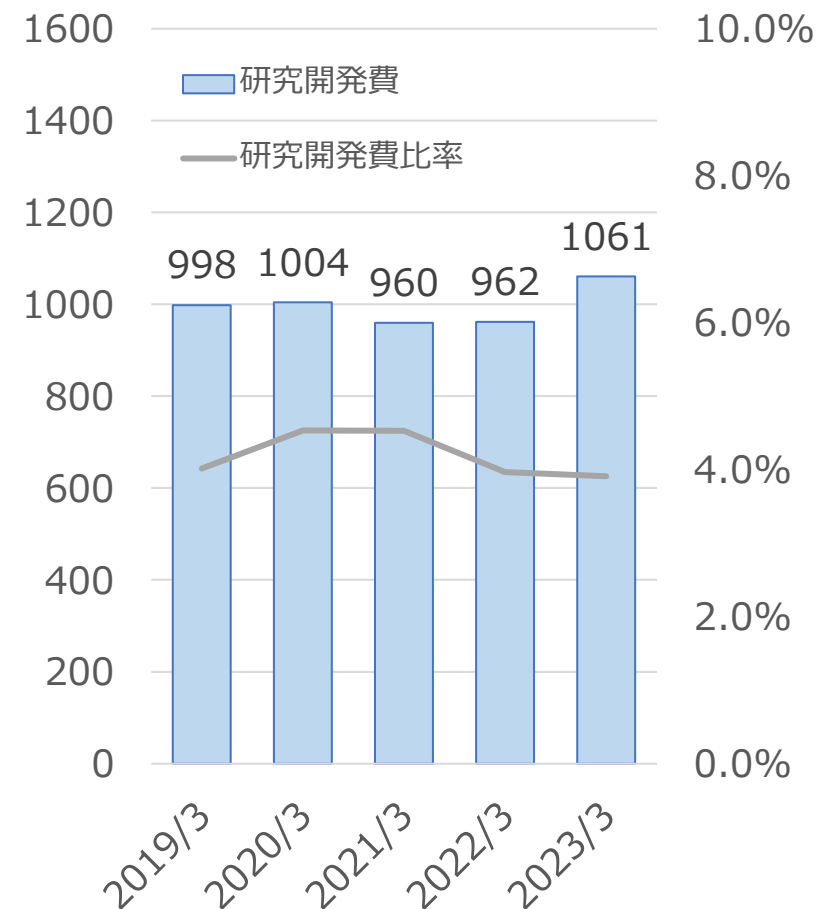
設備投資額



減価償却費



研究開発費および 売上高研究開発費比率



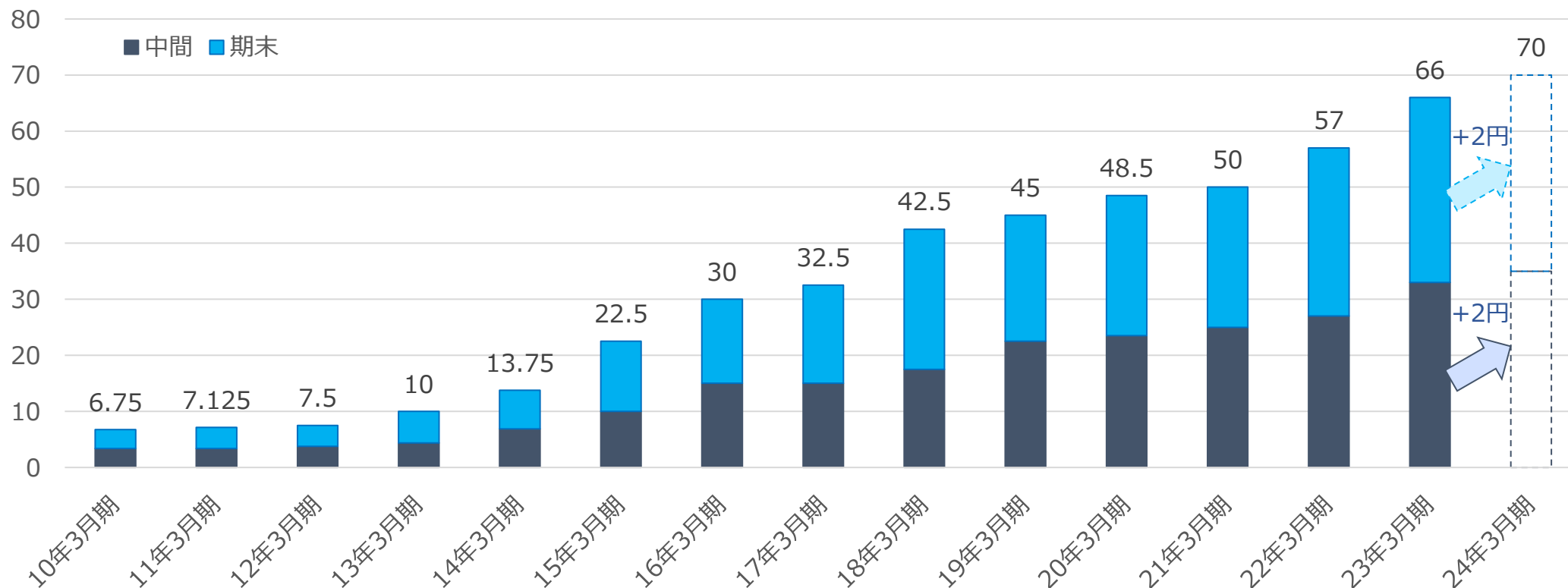
2024年3月期 配当予想



1株当たりの配当金
(予想)

中間配当金：35円
期末配当金：35円

14期連続増配予定



当社は、持続的な成長を達成するため手元流動性を確保し、安定した財務基盤を維持しつつ、成長投資を継続してまいります。
配当は、安定増配基調継続を目指し、機動的な自己株式の取得による株主還元の実施を基本方針としております。

ESGに関する取り組み



当社グループは、ESGに配慮した課題に事業活動を通じて取り組み、持続可能な成長を続けるグローバル企業を目指してまいります。

Environment



環境配慮型製品の開発

- －自動車部品向け6価クロムフリープロセス
- －低環境負荷DFR剥離用アミンフリープロセス
- －低環境負荷ノーシアン銀めっきプロセス



CO₂排出量（単体）

1,168 t-CO₂【2021年度実績】
※2013年度比19.7%削減

Social



女性管理職比率（単体）

11.3%【2023年3月期末】



国内外拠点のISO9001取得状況

7か国12拠点【2023年3月期末】
※日本、中国、台湾、韓国、タイ
ベトナム、メキシコ

Governance



企業統治の体制

- 取締役
社内：6名、社外：4名（内、女性1名）
- 監査役
常勤：1名、社外：3名（内、女性1名）

- 会社概要
- 今後必要とされる表面処理技術
- 主な商流
- 主な製品
- 薬品用途説明 最終製品例

会社概要



創業	：	1957年 12月
設立	：	1968年 4月 1日
資本金	：	12億5,533万円
年商	：	単体 126億円 連結 271億円 (2023年3月期末)
本社所在地	：	東京都台東区東上野 4-8-1 TIXTOWER UENO 16階
業務内容	：	表面処理薬品、表面処理装置及び関連資材の製造・販売
代表者	：	代表取締役社長兼CEO 木村 昌志
従業員数	：	単体 238名 連結 544名 (2023年3月期末)

ISO認証取得

ISO9001 生産本部・本社営業部・総合研究所 JCQA-0281

ISO14001 生産本部・総合研究所 JCQA-E-0143

今後必要とされる表面処理技術 – 電子分野 –

ターゲット

高機能電子デバイス、通信インフラ、カーエレクトロニクスなどの次世代IC-PKG基板

注力すべき表面処理技術

ビアフィリング
めっき技術

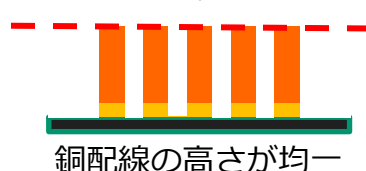
エッチング技術

①面内均一性向上

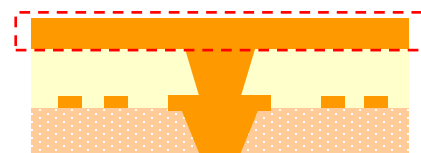
これまで



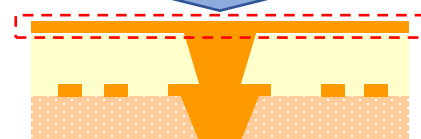
今後の技術



②薄膜埋まり性向上



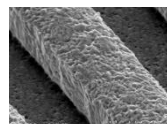
穴を埋める際、表層膜厚が厚くなる



穴を埋める際、表層膜厚を薄くする

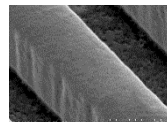
③矩形性維持&平滑性向上

これまで



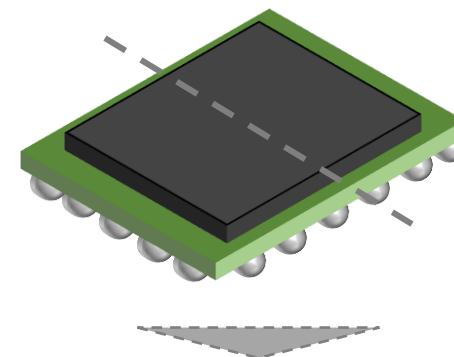
エッチング後の銅配線表面が粗れて凹凸ができる

今後の技術

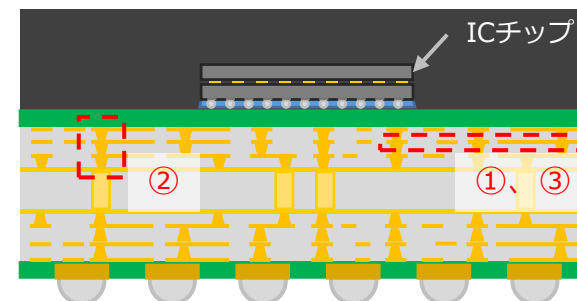


エッチング後の銅配線表面が滑らかな状態を維持できる

半導体パッケージ基板の模式図



半導体パッケージ基板の断面図



今後必要とされる表面処理技術 – 装飾・機能分野 –

ターゲット

自動車部品（フロントグリル、ドアハンドル、エンブレム等）、
水栓部品（シャワーヘッド、排水栓等）

注力すべき表面処理技術

低環境負荷
表面処理技術

①環境規制物質不使用の代替プロセス

これまで



人体に有害とされる
6価クロムイオン

使用される工程

- ・前処理
－エッチング
- ・後処理
－めっき
－電解化成処理

今後の技術



全工程で人体に有害とされる
6価クロムイオンを使用しない
環境配慮型プロセスの展開

各種めっき後の
外観写真



②低環境負荷装飾用銅めっきプロセス



染料系銅めっき用
添加剤

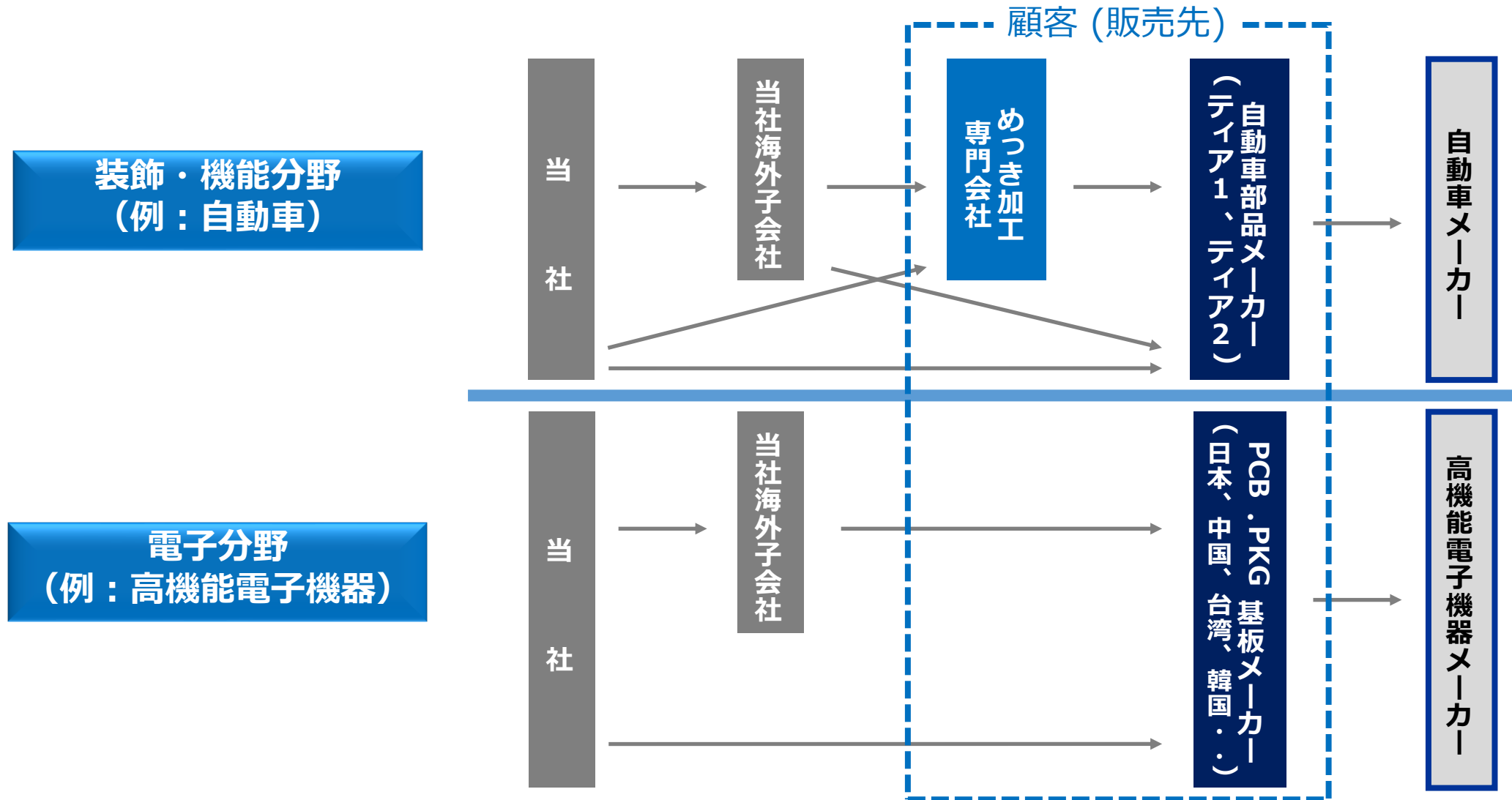
製造工程で環境負荷の
高い薬品を使用

低環境負荷

環境に負荷がかかる薬品を使用せず、
従来と同等の性能を実現する
非染料系銅めっき用添加剤を開発



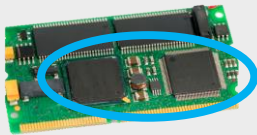
主な商流



主な製品



薬品事業	装飾・防錆分野向け (基幹薬品)	自動車部品（フロントグリル、ドアハンドル、エンブレム等） 水栓金具（給水機器、シャワーヘッド、排水栓等） 建築部品（ボルト、ナット等）
	電子分野向け (電子薬品)	プリント配線板（両面板、多層板、ビルドアップ配線板、パッケージ基板等） 電子部品（リードフレーム、チップ部品、コネクタ等） 半導体（シリコンウエハー）
装置事業	全自動表面処理装置	素材の投入からめっきの完成まで自動運転をする装置
	付帯機器	表面処理装置に付随する、ろ過機等の付帯機器の製造販売
	自動分析管理装置	めっき液の濃度を分析し不足分を補給して、自動で管理する装置
	プラズマ装置	プリント配線板のめっき前処理用等の洗浄処理装置

用語説明		最終製品
基幹薬品	装飾・防錆分野向け、金属外観の付与、サビ防止などの機能性付与のための表面処理(めっき)薬品。	自動車部品、水栓金具、建築部品
POP薬品 (Plating on Plastics)	基幹薬品の主力製品 プラスチック上へ金属膜をめっきするための薬品 	(自動車部品) フロントグリル、エンブレム など (水栓金具) シャワーヘッド、水栓コック など
その他基幹薬品	銅・鉄鋼などの金属素材へ金属膜をめっきするための薬品	(建築部品) ネジ、蝶番 など
電子薬品	電子信号を流すための回路、電子部品の電気接点などプリント配線板を製造するためのめっき薬品	5G関連部品、データセンター等のインフラ、高機能電子デバイス
ビアフィル薬品 (プリント基板/マザーボード向け)	電子製品に内蔵される プリント基板/マザーボードに 配線を形成するための銅めっき薬品 	(5G関連部品) 5G基地局、車載基板、スマート家電 など
ビアフィル薬品 (半導体パッケージ(PKG)基板向け)	半導体チップを外部環境から保護し、 プリント基板に実装するための 基板(半導体PKG基板)に、配線を 形成するための銅めっき薬品 	(データセンター等のインフラ) 通信サーバー向けマザーボード など (高機能電子デバイス) スマートフォン、PC、タブレット、ゲーム機器 など
その他電子薬品	マザーボード、または半導体PKG基板に配線を形成する際、不要な銅を削るためのエッチング薬品 コネクタ、リードフレーム用のめっき薬品など	

この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは異なる場合があります、この資料はその実現を確約したり、保証するものではありません。

当社ホームページ：
<https://www.jcu-i.com/>

お問い合わせ先：経営戦略室
Email： ir2@jcu-i.com
TEL： 03-6895-7004